

Semiconductor Package Business Strategy 2021

目次

1. パッケージビジネスの現状と展望

1-1 パッケージビジネスの現状と展望	2
1-1-1 世界半導体産業の売上推移と展望	3
1-1-2 世界半導体後工程市場・世界 OSAT 上位 20 社の売上推移と展望 "	3
1-1-3 世界パッケージ市場・世界 OSAT 上位 20 社の売上推移と展望 "	4
1-1-4 世界 OSAT 上位 20 社の売上推移と展望	4
1-1-5 世界 OSAT 上位 20 社の企業別売上実績	5
1-1-6 2020 年度の世界 OSAT 上位 20 社の国籍別社数構成比	6
1-1-7 2019 年度の世界 OSAT 上位 20 社の国籍別売上構成比	6
1-2 後工程製造拠点および設備投資状況	7
1-2-1 2020 年度の後工程工場世界分布 (日本を除く)	8
1-2-2 2020 年度の世界 OSAT 上位 20 社の後工程工場世界分布 (日本を除く) "	8
1-2-3 世界半導体設備投資の推移と展望	9
1-2-4 世界半導体後工程設備投資の推移と展望	9
1-2-5 世界 OSAT 上位 20 社の企業別後工程設備投資実績	10
1-2-6 2019 年度の世界 OSAT 上位 20 社の国籍別設備投資構成比 "	10

2. 国内半導体企業のパッケージ事業戦略

2-1 ソニー株式会社	12
1) 事業戦略	12
2) 設備投資	13
3) 開発と今後の方向性	13
4) 半導体売上状況	14
5) 設備投資状況	14
6) 工場別提供パッケージ	15
7) 各工場のライン別一覧	16
2-2 東芝デバイス&ストレージ株式会社・キオクシア株式会社	20
1) 事業戦略	20
2) 設備投資	21
3) 開発と今後の方向性	21
4) 半導体売上状況	22
5) 設備投資状況	22
6) 工場別提供パッケージ	23
7) 各工場のライン別一覧	24
2-3 ルネサスエレクトロニクス株式会社	30
1) 事業戦略	30
2) 設備投資	31
3) 開発と今後の方向性	31
4) 半導体売上状況	32
5) 設備投資状況	32
6) 工場別提供パッケージ	33
7) 各工場のライン別一覧	34
2-4 ローム株式会社	42
1) 事業戦略	42
2) 設備投資	43
3) 開発と今後の方向性	43
4) 半導体売上状況 - (1) 全社製品別	44
4) 半導体売上状況 - (2) 後工程関連	44
5) 設備投資状況 - (1) 全社製品別	45
5) 設備投資状況 - (2) 後工程関連	45
6) 工場別提供パッケージ	46
7) 各工場のライン別一覧	47

2-5 シャープ株式会社	56
1) 事業戦略	56
2) 設備投資	57
3) 開発と今後の方向性	57
4) 半導体売上状況	58
5) 設備投資状況	58
6) 工場別提供パッケージ	59
7) 各工場のライン別一覧	60
2-6 三菱電機株式会社	64
1) 事業戦略	64
2) 設備投資	65
3) 開発と今後の方向性	65
4) 半導体売上状況	66
5) 設備投資状況	66
6) 工場別提供パッケージ	67
7) 各工場のライン別一覧	68
2-7 サンケン電気株式会社	76
1) 事業戦略	76
2) 設備投資	77
3) 開発と今後の方向性	77
4) 半導体売上状況	78
5) 設備投資状況	78
6) 工場別提供パッケージ	79
7) 各工場のライン別一覧	80
2-8 富士電機株式会社	89
1) 事業戦略	89
2) 設備投資	90
3) 開発と今後の方向性	90
4) 半導体売上状況	91
5) 設備投資状況	91
6) 工場別提供パッケージ	92
7) 各工場のライン別一覧	93
2-9 浜松ホトニクス株式会社	100
1) 事業戦略	100
2) 設備投資	101
3) 開発と今後の方向性	101
4) 半導体売上状況	102
5) 設備投資状況	102
6) 工場別提供パッケージ	103
7) 各工場のライン別一覧	104
2-10 セイコーエプソン株式会社	109
1) 事業戦略	109
2) 設備投資	109
3) 開発と今後の方向性	109
4) 半導体売上状況	110
5) 設備投資状況	110
6) 工場別提供パッケージ	111
7) 各工場のライン別一覧	112
2-11 新日本無線株式会社	115
1) 事業戦略	115
2) 設備投資	116
3) 開発と今後の方向性	116
4) 半導体売上状況	117
5) 設備投資状況	117
6) 工場別提供パッケージ	118
7) 各工場のライン別一覧	119
2-12 新電元工業株式会社	121
1) 事業戦略	121
2) 設備投資	121
3) 開発と今後の方向性	122
4) 半導体売上状況	123

5) 設備投資状況	123	7) 各工場のライン別一覧	177
6) 工場別提供パッケージ	124	3-2 Micron Technology	181
7) 各工場のライン別一覧	125	1) 事業戦略	181
2-13 ミネベアミツミ株式会社	129	2) 設備投資	182
1) 事業戦略	129	3) 開発と今後の方向性	182
2) 設備投資	130	4) 半導体売上状況	183
3) 開発と今後の方向性	130	5) 設備投資状況	183
4) 半導体売上状況	131	6) 工場別提供パッケージ	184
5) 設備投資状況	131	7) 各工場のライン別一覧	185
6) 工場別提供パッケージ	132	3-3 Texas Instruments	190
7) 各工場のライン別一覧	133	1) 事業戦略	190
2-14 コーデンシ株式会社	135	2) 設備投資	191
1) 事業戦略	135	3) 開発と今後の方向性	191
2) 設備投資	136	4) 半導体売上状況	192
3) 開発と今後の方向性	136	5) 設備投資状況	192
4) 半導体売上状況	137	6) 工場別提供パッケージ	193
5) 設備投資状況	137	7) 各工場のライン別一覧	194
6) 工場別提供パッケージ	138	3-4 Analog Devices	199
7) 各工場のライン別一覧	139	1) 事業戦略	199
2-15 スタンレー電気株式会社	142	2) 設備投資	200
1) 事業戦略	142	3) 開発と今後の方向性	200
2) 設備投資	143	4) 半導体売上状況	201
3) 開発と今後の方向性	143	5) 設備投資状況	201
4) 半導体売上状況	144	6) 工場別提供パッケージ	202
5) 設備投資状況	144	7) 各工場のライン別一覧	203
6) 工場別提供パッケージ	145	3-5 ON Semiconductor	205
7) 各工場のライン別一覧	146	1) 事業戦略	205
2-16 京セラ株式会社	151	2) 設備投資	206
1) 事業戦略	151	3) 開発と今後の方向性	206
2) 設備投資	151	4) 半導体売上状況	207
3) 開発と今後の方向性	152	5) 設備投資状況	207
4) 半導体売上状況	153	6) 工場別提供パッケージ	208
5) 設備投資状況	153	7) 各工場のライン別一覧	209
6) 工場別提供パッケージ	154	3-6 Samsung Electronics	220
7) 各工場のライン別一覧	155	1) 事業戦略	220
2-17 株式会社京都セミコンダクター	158	2) 設備投資	221
1) 事業戦略	158	3) 開発と今後の方向性	221
2) 設備投資	159	4) 半導体売上状況	222
3) 開発と今後の方向性	159	5) 設備投資状況	222
4) 半導体売上状況	160	6) 工場別提供パッケージ	223
5) 設備投資状況	160	7) 各工場のライン別一覧	224
6) 工場別提供パッケージ	161	3-7 SK Hynix	226
7) 各工場のライン別一覧	162	1) 事業戦略	226
2-18 株式会社オリジン	164	2) 設備投資	227
1) 事業戦略	164	3) 開発と今後の方向性	227
2) 設備投資	164	4) 半導体売上状況	228
3) 開発と今後の方向性	165	3-8 TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation)	233
4) 半導体売上状況	166	1) 事業戦略	233
5) 設備投資状況	166	2) 設備投資	234
6) 工場別提供パッケージ	167	3) 開発と今後の方向性	234
7) 各工場のライン別一覧	168	4) 半導体売上状況	236
3. 海外半導体企業のパッケージ事業戦略		5) 設備投資状況	236
3-1 Intel Corporation	172	6) 工場別提供パッケージ	237
1) 事業戦略	172	7) 各工場のライン別一覧	238
2) 設備投資	173	3-9 STMicroelectronics	242
3) 開発と今後の方向性	174	1) 事業戦略	242
4) 半導体売上状況	175	2) 設備投資	243
5) 設備投資状況	175	3) 開発と今後の方向性	243
6) 工場別提供パッケージ	176	4) 半導体売上状況	245
		5) 設備投資状況	245

Semiconductor Package Business Strategy 2021

6) 工場別提供パッケージ	246	3) 開発と今後の方向性	321
7) 各工場のライン別一覧	247	4) 半導体売上状況	322
3-10 Infineon Technologies	254	5) 設備投資状況	322
1) 事業戦略	254	6) 工場別提供パッケージ	323
2) 設備投資	255	7) 各工場のライン別一覧	324
3) 開発と今後の方向性	255	4-7 東洋電子工業株式会社	326
4) 半導体売上状況	257	1) 事業戦略	326
5) 設備投資状況	257	2) 設備投資	326
6) 工場別提供パッケージ	258	3) 開発と今後の方向性	326
7) 各工場のライン別一覧	259	4) 半導体売上状況	327
3-11 NXP Semiconductors	275	5) 設備投資状況	327
1) 事業戦略	275	6) 工場別提供パッケージ	328
2) 設備投資	276	7) 各工場のライン別一覧	329
3) 開発と今後の方向性	276	4-8 株式会社野田市電子	332
4) 半導体売上状況	277	1) 事業戦略	332
5) 設備投資状況	277	2) 設備投資	332
6) 工場別提供パッケージ	278	3) 開発と今後の方向性	332
7) 各工場のライン別一覧	279	4) 半導体売上状況	333
		5) 設備投資状況	333
		6) 工場別提供パッケージ	334
		7) 各工場のライン別一覧	335
		4-9 大津電子株式会社	337
		1) 事業戦略	337
		2) 設備投資	337
		3) 開発と今後の方向性	337
		4) 半導体売上状況	338
		5) 設備投資状況	338
		6) 工場別提供パッケージ	339
		7) 各工場のライン別一覧	340

4. 国内 OSAT 企業のパッケージ事業戦略

4-1 アオイ電子株式会社	284
1) 事業戦略	284
2) 設備投資	285
3) 開発と今後の方向性	285
4) 半導体売上状況	286
5) 設備投資状況	286
6) 工場別提供パッケージ	287
7) 各工場のライン別一覧	288
4-2 新光電気工業株式会社	292
1) 事業戦略	292
2) 設備投資	293
3) 開発と今後の方向性	293
4) 半導体売上状況	294
5) 設備投資状況	294
6) 工場別提供パッケージ	295
7) 各工場のライン別一覧	296
4-3 株式会社加藤電器製作所	297
1) 事業戦略	297
2) 設備投資	298
3) 開発と今後の方向性	298
4) 半導体売上状況	299
5) 設備投資状況	299
6) 工場別提供パッケージ	300
7) 各工場のライン別一覧	301
3) 開発と今後の方向性	306
4) 半導体売上状況	307
5) 設備投資状況	307
6) 工場別提供パッケージ	308
7) 各工場のライン別一覧	309
4-5 エムテックスマツムラ株式会社	312
1) 事業戦略	312
2) 設備投資	312
3) 開発と今後の方向性	313
4) 半導体売上状況	314
5) 設備投資状況	314
6) 工場別提供パッケージ	315
7) 各工場のライン別一覧	316
4-6 株式会社ミスズ工業	320
1) 事業戦略	320
2) 設備投資	320

5. 海外 OSAT 企業のパッケージ事業戦略

5-1 ASE (Advanced Semiconductor Engineering)	342
1) 事業戦略	342
2) 設備投資	343
3) 開発と今後の方向性	343
4) 半導体売上状況	345
6) 工場別提供パッケージ	346
7) 各工場のライン別一覧	347
5-2 Amkor Technology	365
1) 事業戦略	365
2) 設備投資	366
3) 開発と今後の方向性	367
4) 半導体売上状況	369
5) 設備投資状況	369
6) 工場別提供パッケージ	370
7) 各工場のライン別一覧	371
5-3 JCET Group	389
1) 事業戦略	389
2) 設備投資	390
3) 開発と今後の方向性	391
4) 半導体売上状況	393
5) 設備投資状況	393
6) 工場別提供パッケージ	394
7) 各工場のライン別一覧	395
5-4 Powertech Technology	401
1) 事業戦略	401
2) 設備投資	402
3) 開発と今後の方向性	403
4) 半導体売上状況	405
5) 設備投資状況	405

6) 工場別提供パッケージ	406	3) 開発と今後の方向性	495
7) 各工場のライン別一覧	407	4) 半導体売上状況	496
5-5 Tongfu Microelectronics (通富微電子)	422	5) 設備投資状況	496
1) 事業戦略	422	6) 工場別提供パッケージ	497
2) 設備投資	423	7) 各工場のライン別一覧	498
3) 開発と今後の方向性	424	5-13 Carsem	501
4) 半導体売上状況	425	1) 事業戦略	501
5) 設備投資状況	425	2) 設備投資	501
6) 工場別提供パッケージ	426	3) 開発と今後の方向性	502
7) 各工場のライン別一覧	427	4) 半導体売上状況	503
5-6 Tianshui Huatian Technology (TSHT)	434	5) 設備投資状況	503
1) 事業戦略	434	6) 工場別提供パッケージ	504
2) 設備投資	435	7) 各工場のライン別一覧	505
3) 開発と今後の方向性	436	5-14 Formosa Advanced Technologies (FATC)	508
4) 半導体売上状況	437	1) 事業戦略	508
5) 設備投資状況	437	2) 設備投資	509
6) 工場別提供パッケージ	438	3) 開発と今後の方向性	509
7) 各工場のライン別一覧	439	4) 半導体売上状況	510
5-7 ChipMOS Technologies	446	5) 設備投資状況	510
1) 事業戦略	446	6) 工場別提供パッケージ	511
2) 設備投資	447	7) 各工場のライン別一覧	512
3) 開発と今後の方向性	447	5-15 Nepes	513
4) 半導体売上状況	449	1) 事業戦略	513
5) 設備投資状況	449	2) 設備投資	514
6) 工場別提供パッケージ	450	3) 開発と今後の方向性	515
7) 各工場のライン別一覧	451	4) 半導体売上状況	516
5-8 Chipbond Technology	456	5) 設備投資状況	516
1) 事業戦略	456	6) 工場別提供パッケージ	517
2) 設備投資	457	7) 各工場のライン別一覧	518
3) 開発と今後の方向性	457	5-16 Walton Advanced Engineering	524
4) 半導体売上状況	458	1) 事業戦略	524
5) 設備投資状況	458	2) 設備投資	525
6) 工場別提供パッケージ	459	3) 開発と今後の方向性	525
7) 各工場のライン別一覧	460	4) 半導体売上状況	526
5-9 UTAC	465	5) 設備投資状況	526
1) 事業戦略	465	6) 工場別提供パッケージ	527
2) 設備投資	466	7) 各工場のライン別一覧	528
3) 開発と今後の方向性	467	5-17 Signetics	533
4) 半導体売上状況	469	1) 事業戦略	533
5) 設備投資状況	469	2) 設備投資	533
6) 工場別提供パッケージ	470	3) 開発と今後の方向性	534
7) 各工場のライン別一覧	471	4) 半導体売上状況	535
5-10 OSE (Orient Semiconductor Electronics)	479	5) 設備投資状況	535
1) 事業戦略	479	6) 工場別提供パッケージ	536
2) 設備投資	480	7) 各工場のライン別一覧	537
3) 開発と今後の方向性	480		
4) 半導体売上状況	481		
5) 設備投資状況	481		
6) 工場別提供パッケージ	482		
7) 各工場のライン別一覧	483		
5-11 SFA Semicon	484		
1) 事業戦略	484		
2) 設備投資	485		
3) 開発と今後の方向性	485		
4) 半導体売上状況	487		
5) 設備投資状況	487		
6) 工場別提供パッケージ	488		
7) 各工場のライン別一覧	489		
5-12 HANA Micron	493		
1) 事業戦略	493		
2) 設備投資	494		